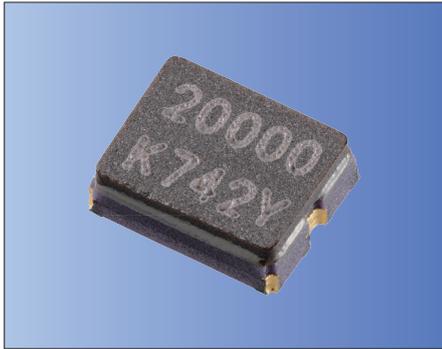


表面贴装型 CX2016GR [车载应用]

2.0×1.6mm



AEC-Q200 RoHS指令对应产品

■特点

- 车载应用晶体谐振器
- 小型(2.0×1.6×0.8mm)
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊
- 耐用的全陶瓷封装可对应树脂模
- 热循环焊接强度：-40～125℃、3000次

■用途

- ECU
- 车载摄像机
- 雷达

■型号表示方法

CX2016GR 27000 D0 G T V CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称
②频率
③负载容量
④频率容差
(常温偏差)

D0 8 pF
G ±15×10⁻⁶

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

TV -40～+150℃ ±150×10⁻⁶

⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 3000/ 15000个/卷盘)

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f _{nom}	16000～60000	kHz	
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f _{tol}	±50	×10 ⁻⁶	25℃±3℃
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T _{use}	-40～+150	℃	
储存温度范围	T _{stg}	-40～+150	℃	
频率温度特性	f _{tem}	±150	×10 ⁻⁶	对于25℃频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

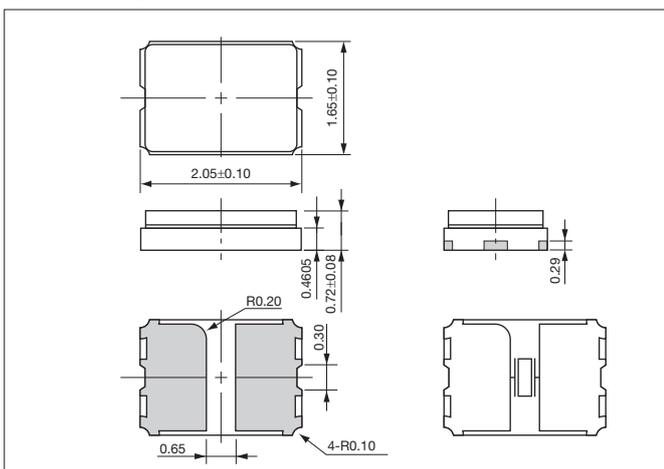
频率范围	串联电阻
16000≤f _{nom} <18000kHz	300Ω max.
18000≤f _{nom} <20000kHz	200Ω max.
20000≤f _{nom} <40000kHz	100Ω max.
40000≤f _{nom} ≤60000kHz	50Ω max.

■Table2 激励级

频率范围	激励级
16000≤f _{nom} ≤60000kHz	10μW(200μW max.)

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

